



JD-727

無溶劑型矽質絕緣樹脂

特 點

- 100%固成分、無溶劑、低黏度。
- 濕氣硬化機制，與空氣中濕氣作用以形成彈性保護層，可採室溫硬化或加溫硬化。
- 硬化後為柔軟彈性體，具優良的絕緣、防潮及耐緩衝的特性。
- 適用於多數基材並達良好的附著性，可廣泛用於電路板或電子零件作為保護絕緣用途。
- 符合 UL94 V-0，符合 RoHS 規範。

基 本 物 性

外 觀：	半透明液體
黏 度：	500 ~ 600 cps
比 重：	0.95 ~ 1.05
表 乾 時 間：@25°C	10 ~ 15分鐘(依塗層厚度而有差異)
硬 化 時 間：	25°C x 24小時
	*若欲加溫硬化，建議： 以@60°C以下溫度並同時增加濕度(RH 55~75%)
硬 度：Shore A	30 ~ 36
耐 溫 範 圍：	-40°C ~ +200°C
玻璃轉化溫度(Tg)：	<40°C
絕 緣 強 度：	20 kV/mm
抗 張 強 度：	0.5 MPa
斷 裂 延 伸 率：	60%
體 積 電 阻：	1.5×10^{14} ohm · cm
絕 緣 常 數：1MHz	3.0
介 電 損 耗：1MHz	4×10^{-3}
保 存 期 限：@25°C	6個月(未開封)

注 意 事 項

- 為獲得達到最佳的保護效果，操作前請先將基板或工件做好前處理與清潔工序。
- 與空氣濕氣接觸時，表面會開始反應結皮，然後由表面逐漸往內層硬化。硬化的速度會因為塗覆的厚度、空氣濕度與溫度受到影響。厚度越厚或是相對濕度較低，硬化所需的時間也可能因此需要延長，或是請改以加熱方式硬化。
- 開罐後，未使用完畢請密封保存，避免接觸空氣/水氣而影響保存期限。

